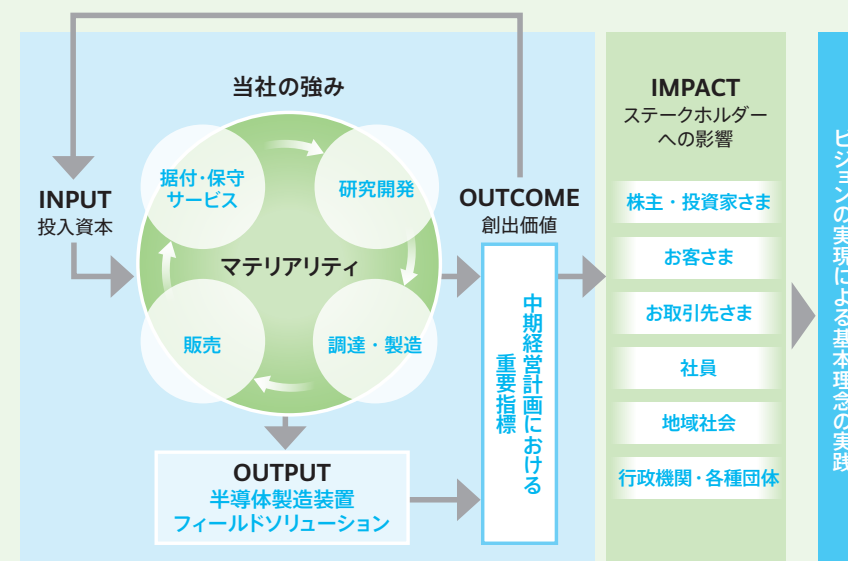


Chapter 2

価値創造ストーリー

- 14 当社の強み
- 15 価値創造モデル
- 17 中期経営計画
- 23 中長期的な展望
- 25 マテリアリティ
- 27 ステークホルダーエンゲージメント



当社は独自の強みを生かし、マテリアリティを軸とした事業活動により、中期経営計画の達成とさらなる成長に向けた取り組みを展開しています。社会における役割と責任を確実に果たしていくことで、ステークホルダーとの確固たる信頼関係を構築し、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努めていきます。

当社の強み

当社がこれまで培ってきた強みをさらに磨き、挑戦と進化を続けながら、事業活動における優位性として最大限に生かすことでさらなる成長を目指しています。

半導体の微細加工に必要な成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄という

4つのキーププロセスの先端装置を提供するメーカー



半導体の進化に必要なEUV※1露光用の塗布現像装置のシェア※2が**100%**

※1 EUV: Extreme Ultraviolet. 半導体業界では特定の波長13.5nmを使用した露光技術の総称

※2 当社推定



当社の製品群は各セグメントで強いポジションにあり、

いずれも市場シェア※3 **上位**を獲得

※3 当社推定

※4 各セグメントにおける当社の製品群: 拡散炉は熱処理成膜、パッチ成膜はALD (Atomic Layer Deposition) と CVD (Chemical Vapor Deposition)、メタル成膜は枚葉成膜、洗浄は枚葉洗浄とパッチ洗浄をそれぞれ含む



お客さまとの絶対的な信頼関係のもと、**業界最大**※5の出荷実績を生かして展開する

技術サービスとマーケティング

※5 当社推定

※6 2026年3月末時点



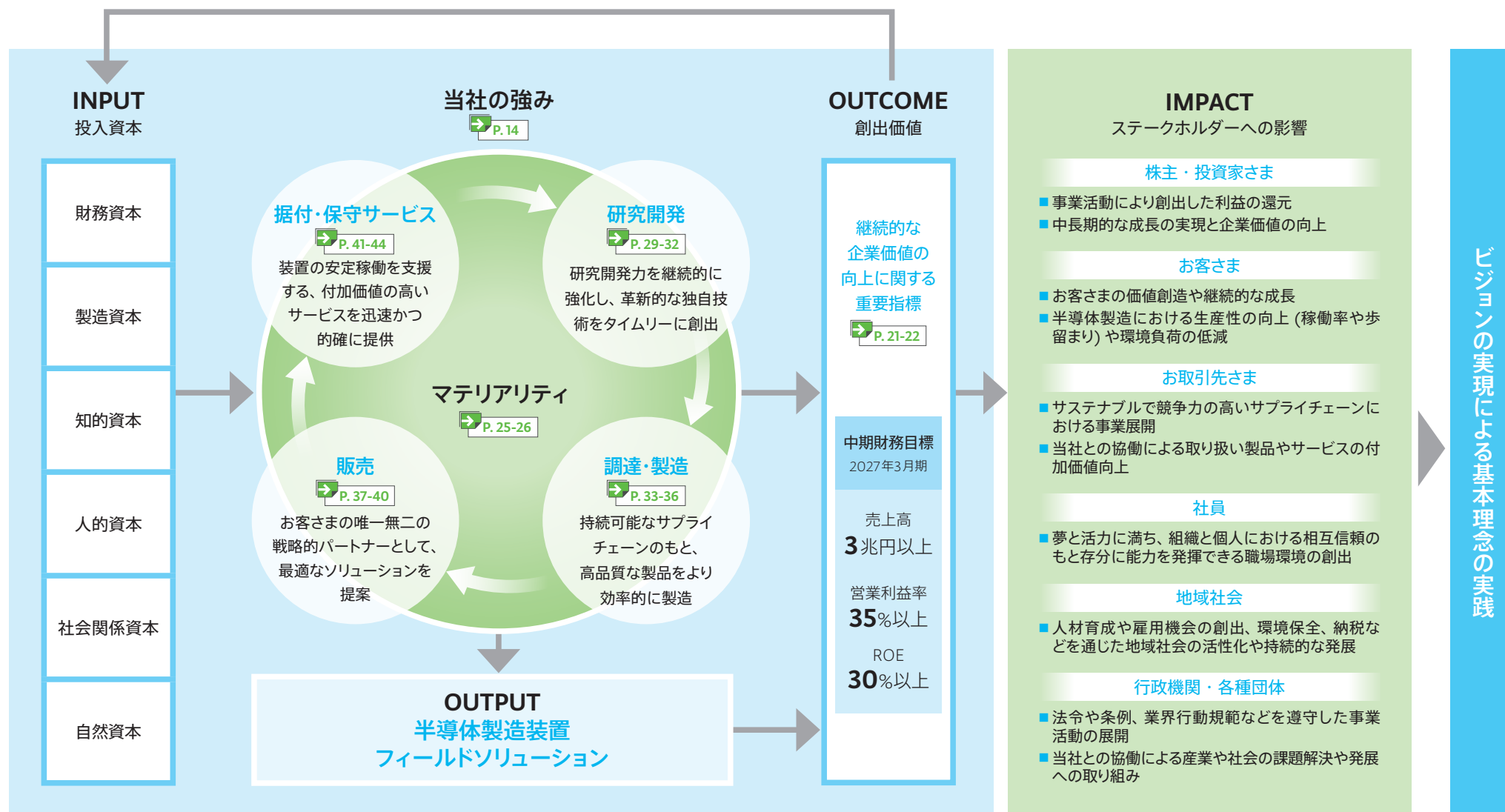
特許保有件数が半導体製造装置業界においてグローバル**No. 1**

※7 2026年3月末時点。LexisNexis® PatentSight+データに基づき作成



価値創造モデル

当社は保有する資本を最大限に活用し (INPUT)、強みを生かしながらマテリアリティを軸とした事業活動を展開しています。これにより創出される価値 (OUTCOME) をステークホルダーに提供します。そしてビジョンの実現による基本理念の実践を通じ、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指しています。



価値創造モデル

INPUT (投入資本) およびOUTCOME (創出価値) の2026年3月期実績は以下のとおりです。

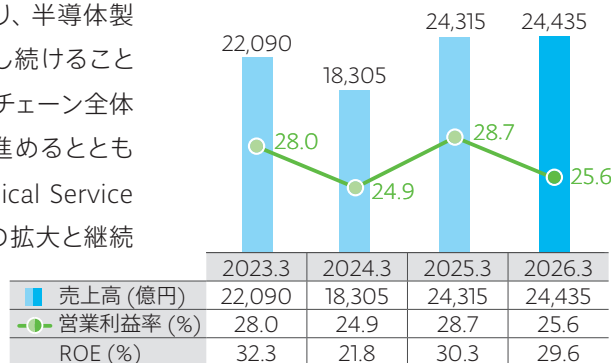
資本	INPUT (投入資本) 2026年3月期		OUTCOME (創出価値) 2026年3月期	
財務資本	●純資産 2兆699億円 ●自己資本比率 71.5% ●総資産 2兆8,609億円		●売上高 2兆4,435億円 ●営業利益率 25.6% ●当期純利益 5,744億円 ●ROE 29.6% ●年間配当総額 2,874億円 (配当性向50.1%)	
製造資本	●製造拠点 合計 9 (国内6、海外3) ●新工場建屋や設備など製造に関する設備投資 ●部品の標準化・生産の平準化 ●製造オペレーションにおける長年培ったノウハウや実績 ●製造基幹システム		●累計出荷台数 約100,000台 (年間出荷台数 約4,000台) ●最先端技術を備えた高品質、高信頼性の製品 ●安全第一のオペレーション TCIR 0.22 ●生産リードタイムの短縮	
知的資本	●研究開発拠点 合計 19 (国内8、海外11) ●研究開発投資 2,778億円 ●複数の領域における高い専門性とそれらを統合して製品化する能力 ●半導体製造プロセスにおける幅広い知見と総合的な技術力 ●お客さまのご要望や技術動向 ●デジタル技術やナレッジマネジメントにより蓄積された装置関連データ		●革新的で付加価値の高い独自技術 ●市場シェア※1 上位の充実した製品群 ●半導体製造における最適なソリューション ●特許保有件数 26,592件 (保有特許増加件数 1,596件) ●高品質かつ高効率なサービス ※1 当社推定	
人的資本	●従業員数 20,236名 ●エンジニア比率 68.9% ●さまざまな専門分野の知見を備えた人材 ●グローバルに活躍できる人材 ●TEL UNIVERSITYによる人材開発		●定着率※2 97.8% ●価値創出の源泉である社員の成長意欲の向上とチャレンジ精神の発揮 ●エンゲージメントの高い社員によるステークホルダーとの信頼関係の構築 ●女性管理職比率※3 6.8% ※2 離職率のデータを用いて算出 ※3 高度専門職と定年後再雇用者を含む	
社会関係資本	●長年の実績に基づくお客さまとの信頼関係 ●お取引先さまとの強固なパートナーシップ ●地域社会における事業活動の基盤 ●業界団体における同業他社との連携		●顧客満足度調査「非常に満足」または「やや満足」回答割合※4 100% ●事業活動を展開する地域における雇用機会の創出と国・地方自治体への納税 ●TEL FOR GOOD※5 プログラム数 285件 ※4 ご回答いただいたすべてのお客さまのスコア平均値を設問ごとに算出 ※5 当社の社会貢献活動を表すブランドネーム	
自然資本	●エネルギー使用量 620,995MWh ●水使用量 2,077千m³		●自社のCO₂排出量 64%削減 (2019年3月期比、再生可能エネルギー導入などによるCO₂排出量111千t削減) ●製品使用時のCO₂排出量 (ウェーハ1枚当たり) 11%削減 (2022年3月期比) ●廃棄物リサイクル率 98.5%	

中期経営計画

財務目標

当社は2023年3月期に中期経営計画を策定し、ワールドクラスの営業利益率とROE（自己資本利益率）のさらなる向上に向けて、2027年3月期までに売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE 30%以上を目指す財務目標を設定しています。

半導体の重要性が一段と高まり、半導体製造装置市場が今後も大きく成長し続けることが予想される中、当社はバリューチェーン全体におけるさまざまな取り組みを進めるとともに、Best Products、Best Technical Serviceを常に追求し、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指していきます。



主な取り組み

- AI関連需要の拡大に伴う、当社の得意とする先端アプリケーション向け装置の展開加速、フィールドソリューションの事業機会拡大への対応
- 将来、お客さまが必要とする高付加価値のnext-generation productsをいち早く市場に投入するとともに、最高水準の技術サービスを提供
- 積極的な成長投資（研究開発費、設備投資）を実施
- 出荷済み装置をもとにパーツ販売やアップグレード改造、稼働率向上に取り組み、お客さまが生産するデバイスの歩留まり向上などの課題解決に努めるとともに、これらの高度なフィールドソリューションの提供を通じてアフターマーケットでの収益拡大を図る
- 環境イニシアティブ「E-COMPASS」を展開し、サプライチェーン全体で半導体の技術革新と環境負荷低減の実現を目指した活動を実施
- 業務効率化と新たな価値の創造に向けたデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進と体制の強化

CFOメッセージ



川本 弘

常務執行役員 CFO
ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー

当社はビジョンの実現と財務目標の達成に向けて、以下の戦略や政策を実践するとともに、資本市場との対話を通じて企業価値・株主価値の向上に寄与してまいります。

1 成長戦略

- 売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE 30%以上を2027年3月期までに達成する中期財務目標を設定
- 資産効率をさらに高め、キャッシュ・フローの拡大に努めることで、ROE向上など高い資本効率を追求
- 創出したキャッシュを社会の持続的な発展を支える半導体の技術革新を生み出すための成長投資、人材投資に活用

2026年3月期は、データセンター向けAI需要の拡大などによる半導体市場の成長を背景に、過去最高の2兆4,435億円の売上高、5,744億円の当期純利益を達成し、ROEも29.6%となりました。また成長投資として、半導体製造装置のさらなる需要拡大に対応した生産能力の向上、そして将来の半導体製造プロセスに向けた技術開発力の向上を目指した設備投資をおこない、東京エレクトロン宮城と東京エレクトロン九州に新開発棟、東京エレクトロン テクノロジーソリューションズに東北生産・物流センターをそれぞれ竣工しました。

今後も、データ社会への移行、生産性向上や新たな価値創出に向けたAI向け半導体市場の拡大により、半導体製造装置市場は中長期的な成長が見込まれております。当社は開発力強化に向けた成長投資を継続してまいります。



東京エレクトロン宮城
第3開発棟



東京エレクトロン九州
プロセス開発棟



東京エレクトロン テクノロジー
ソリューションズ 東北生産・物流センター

中期経営計画 | CFOメッセージ

2

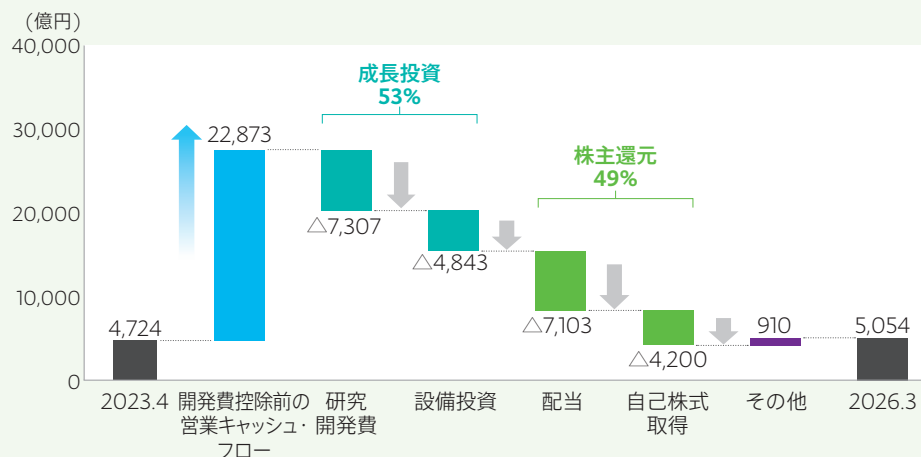
財務戦略

- 事業拡大を見据えた運転資金の確保による経営の安定化
- 強固な財務体質の維持
- 適切なキャッシュアロケーション、バランスシート・マネジメントの追求

当社はこれまで半導体製造装置業界におけるリーディングカンパニーとして大きな成長を遂げてきました。引き続き次の成長投資に向けてキャッシュを有効活用し、中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。

過去3期累計における当社のキャッシュアロケーションでは、開発費控除前の営業キャッシュ・フローとして2兆2,873億円を創出し、およそ53%を成長投資（研究開発費、設備投資）に、49%を株主さまへの還元（配当、自己株式取得）に配分しました。今後も獲得したキャッシュをバランス良くアロケーションし、持続的な企業成長と株主価値の向上を両立してまいります。

■ キャッシュアロケーション（過去3期累計）



3

資本政策

- 自社の企業価値の的確な把握と株価や時価総額の評価
- 資本コストや資本収益性を意識した最適な資本構成の実現
- キャッシュ・フロー拡大に基づく継続的かつ積極的な株主還元の実行

近年の高い利益成長の実績と将来に向けたさらなる成長への期待を背景に、当社の時価総額は高水準となっており、2026年3月末時点の時価総額は17兆5,588億円となりました。また2026年3月末時点のPBR（株価純資産倍率）は8倍以上の水準となっております。当社の企業価値が資本市場で高く評価された結果、純資産と比較して時価総額が大きく増加しました。

過去4期のROEは、目標である30%前後を継続しております。また当社の資本コストは12%程度と見積もっており、ROEから資本コストを差し引いたエクイティ・スプレッドは大幅な超過となっております。

■ 時価総額の推移



4

株主還元策

- 株主さまへの配当については業績連動型を基本とし、親会社株主に帰属する当期純利益に対する連結配当性向50%を目処とする※
- 自己株式の取得については現状のキャッシュポジションや中長期的な成長投資資金、株価水準、総還元額の状況などに鑑み、機動的に実施

※ ただし1株当たりの年間配当金は50円を下回らないこととし、2期連続で当期純利益を生みなかった場合は、配当金の見直しを検討

2026年3月期の株主さまへの総還元額（配当および自己株式取得額）は過去最高の4,374億円、また総還元比率は76.1%となり、高水準の還元をおこないました。

引き続き、高水準の配当と機動的な自己株式の取得による株主還元を通して、株主価値を高めてまいります。

中期経営計画 | 製品事業担当メッセージ



製品事業担当メッセージ

秋山 啓一

コーポレートオフィサー 製品事業担当
専務執行役員

半導体市場は、従来の予測より大幅に前倒して1兆米ドル規模への成長が進むと見込まれています。その成長を牽引するAI向け半導体においては、先端デバイスの進化に加え、先端パッケージングやテストなどの手法も多様化しており、さらなる高性能化や微細化が求められています。このような状況において、当社では半導体の高性能化や微細化を実現するカギとなる多くの主要な前工程製造プロセスを担うポジションを強化すべく積極的に技術開発を進めています。エッチングや成膜などの分野においてWFE※1の成長率を上回る伸びが期待されており、それらを含む前工程事業では多くの開発POR※2を獲得しています。後工程においては、複数のチップを2次元、3次元方向に集積させる先端パッケージングの重要性が一段と高まっています。特にAIが必要とする大量のデータを超高速かつ省電力で移送するための高密度ボンディング技術は、半導体製造における重要な技術転換点として考えられており、高い信頼性と生産性を備えた革新的技術として期待されています。当社は各地域の開発評価センターを活用し、お客さまのニーズに応じた迅速な開発・サポートを提供することで、一層のエンゲージメント強化を図っております。

今後も積極的な技術開発への投資を通じて、半導体市場の成長に強く貢献してまいります。

※1 WFE: Wafer Fab Equipment。半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程がある。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置のこと。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含む

※2 POR: Process of Record

前工程事業

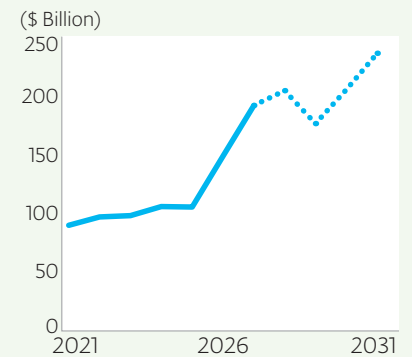
■ 事業機会

AIの進展に伴い、成長が期待される先端ロジックとDRAMにおいてはエッチングのTAM※1の成長率が一段と高まり、成膜においても先端ロジック向けでは高い成長が見込ま

れます。AI向けデバイスの用途の広がり牽引され市場が拡大する中、各デバイスのさらなる高性能化や微細化による高付加価値化が今後も継続していくことが予想されます。2025年に宮城と熊本に新開発棟を、岩手に東北生産・物流センターをそれぞれ竣工するとともに、2027年夏には宮城に生産革新センターの竣工を予定しています。これにより開発能力の強化と生産能力の向上を図り、半導体製造装置市場の成長に備えた体制を整えています。

※1 TAM: Total Available Market

■ 半導体製造装置市場



出典: Technisights (June 2026)

■ 事業戦略

先端ロジックにおいては、成膜・エッチングの精密制御、高選択比のガスケミカルエッチング、エアギャップなどの新構造への対応をおこなうとともに、露光での性能とコストの両立に向けて、EUVのHigh NA (高開口数) 化、マルチパターニングとの併用、レジストへのMOR※2採用、さらにEUV適用回数の最適化を目的とした異方性エッチングの評価を進めていきます。DRAMにおいては、2次元の微細化を成立させるキャパシタ容量の確保のため、高アスペクト比エッチングと、高難度なキャパシタ成膜へのニーズに対応するとともに、新構造の4F²縦型チャネルトランジスタや、3次元構造への変化における成膜、エッチング、ガスケミカルエッチングの技術開発も強化していきます。NANDにおいては、積層数の増加を実現するため、当社の深い穴スリット向けの極低温エッチング開発を強化することに加え、次世代遷移金属材料のワードラインへの適用や、チャネルシリコンの低抵抗化に対応します。高性能化と微細化において極めて重要な役割を果たす多くの技術開発を通じて、半導体の進化に大きく貢献するとともに、新製品の提供により当社事業の参入領域を拡大し、WFEの水準を上回る成長を目指します。さらに、AIとロボティクスを活用した包括的なDXソリューション「Epsira™」を展開し、お客さまと当社の双方で効率的な開発・生産・保守運用ができるよう、さまざまな取り組みを推進していきます。デジタル化に加え、地球環境保全に向けた脱炭素化の両立を図る「デジタル×グリーン」への対応も強化していきます。

※2 MOR: Metal Oxide Resist

中期経営計画 | 製品事業担当メッセージ

前工程事業における当社の優位性

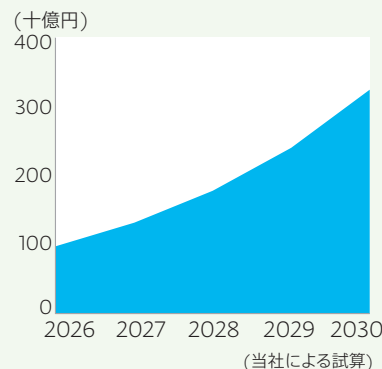
- 高性能化や微細化のカギとなるエッチング、成膜を強い開発体制で実現
- EUVを塗布現像装置と最適化技術で支える
- パターニングにおける4つのキープロセスの先端装置を駆使し全体最適の解を提供

後工程事業

■ 事業機会

近年、すべての先端デバイスの前工程や、後工程における先端パッケージングにおいて、ボンディング技術の採用が進んでいます。先端ロジック半導体においてはBackside PDN^{※1}と呼ばれる裏面配線構造や次世代トランジスタCFET^{※2}、メモリ半導体においてはNAND、DRAMそれぞれにおいて開発が加速しています。また、先端パッケージングにおいては、ウェーハだけでなくダイレベルでのボンディングの重要性も高まっています。例えば、次世代HBM^{※3}やフラッシュ積層メモリ、ロジック半導体や光デバイスの積層において開発、採用が進んでおり、AIデバイスの高性能化に伴いボンディング市場の機会が広がっています。これに伴い、当社が参入しているボンディング工程の製造装置市場は2026年から2030年までの年平均成長率（CAGR）が30%を超える見込みであり、2030年には3,000億円を超える市場規模に達すると予測しています^{※4}。

■ ボンディング工程に関する製造装置市場規模



※1 Backside PDN: Backside Power Delivery Network

※3 HBM: High Bandwidth Memory

※2 CFET: Complementary Field Effect Transistor

※4 当社による試算

■ 事業戦略

当社が提供するボンディング装置は、プラズマ制御や洗浄技術からなるプロセス技術と、メカニカルなアライメント技術が融合されたプロセス装置であり、前工程事業で保有している成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄において培った先端技術や、パーティクル制御など

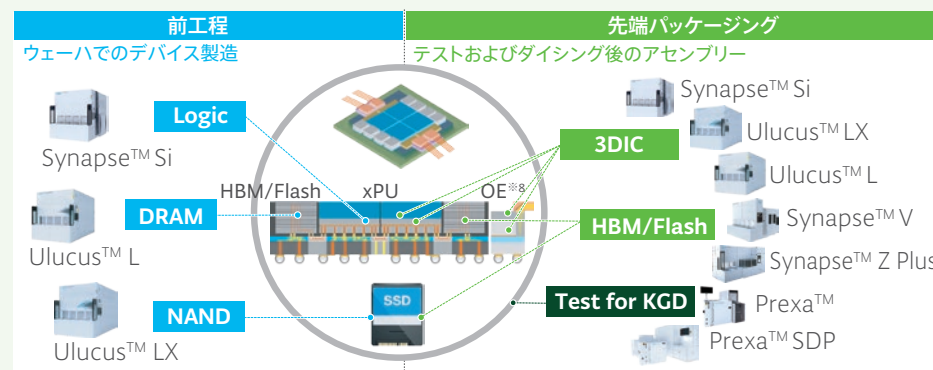
の各種ノウハウを取り入れながら、製品開発を進めています。また、ボンディング市場での事業成長を最大化すべく、ウェーハ永久接合装置「Synapse™ Si」に加えて、プロセス品質やCoO^{※5}の改善に大きな貢献が期待されるレーザエッジトリミング装置「Ulucus™ L」と先端レーザ剥離装置「Ulucus™ LX」をリリースし、お客さまの評価も順調に進んでいます。

さらに、先端パッケージング向けには、ダイレベルでのボンディング装置の開発を加速しており、高精度かつ高信頼性のダイスタックの実現に向け、前処理からボンディングまで一括処理対応可能なクラスター装置を投入予定です。

先端パッケージングにおいては最終歩留まり向上が不可欠であり、そのためには実装前のデバイスを個片化した状態でテストするKGD^{※6}が求められます。先端デバイスにおけるテスト中の吸熱と正確な温度制御の課題に対して、当社は高い吸熱性能を有するデバイスプローバ「Prexa™ SDP^{※7}」の販売を開始しました。ウェーハレベルのソリューションに加えて、ダイおよびデバイスレベルでのソリューションをタイムリーに提供し、相互の融合を通じて、AI向け先端パッケージングにおける最終歩留まり向上を実現していきます。

※5 CoO: Cost of Ownership

※6 KGD: Known Good Die/Device. 良品と判定されたベア・ダイもしくはデバイス ※7 SDP: Singulated Device Prober



※8 OE: Optical Engine for Si Photonics

後工程事業における当社の優位性

- 大きな成長が見込まれるボンディング市場に対し、革新的な製品群を幅広く投入
- 前工程事業で培った技術やノウハウを活用することで、迅速で効果的な開発が可能
- ボンディングとテスト技術を融合することによる、歩留まり向上へのアプローチ

中期経営計画

継続的な企業価値の向上に関する重要指標

中期経営計画において、財務およびサステナビリティに関する指標を「継続的な企業価値の向上に関する重要指標」として明確にし、これらの重要指標と関連する主なマテリアリティを確認しています。CEOが参加する四半期レビュー会議にて定期的に進捗状況やアクションプランの確認をおこない、各指標における責任者のもとさまざまな活動を展開しています。

 当社ウェブサイト「サステナビリティ年度目標と重要指標」 www.tel.co.jp/sustainability/goals-and-results/index.html

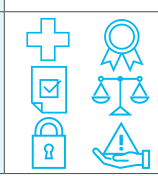
○: 順調に進行中 △: 目標達成に向けて加速が必要

対象分野		指標	達成時期	2026年3月期実績	進捗評価	関連する主なマテリアリティ※1
財務		● 売上高: 3兆円以上	2027年3月期	● 2兆4,435億円	○	
		● 営業利益率: 35%以上	2027年3月期	● 25.6%	△	
		● ROE: 30%以上	2027年3月期	● 29.6%	○	
研究開発		● 5年間で1兆円以上の研究開発費の投入による付加価値の高い next-generation productsの継続的な創出	2027年3月期	● 研究開発費2,778億円	○	
安全		● TCIR※2 0.10未満 (業界グローバル1位)	2027年3月期	● 0.22	△	
環境	事業所	● CO ₂ 総排出量: 85%削減 (2019年3月期比)	2031年3月期	● 64%削減	○	
		● 再生可能エネルギー使用比率: 100%	2031年3月期	● 87%	○	
		● 各事業所におけるエネルギー使用量 (原単位): 前期比1%削減	每期	● 11事業所中、2事業所において達成	△	
		● 各事業所における水使用量 (原単位): 各基準期水準を維持	每期	● 13目標中、6目標において達成	△	
	物流	● モーダルシフトおよび共同配送のさらなる推進による物流全体 (自社配送分) のCO ₂ 排出量: 30%削減	2027年3月期	● 26%削減	○	
		● 製品の木材梱包の使用比率を40%以下に削減 (半導体製造装置の梱包)	2027年3月期	● 52%	○	
	製品	● ウェーハ1枚当たりのCO ₂ 排出量: 55%削減※3 (2022年3月期比)	2031年3月期	● 11%削減	△	
サプライチェーンマネジメント		● サプライチェーンサステナビリティアセスメントの実施率 資材系: 調達額の85%以上 物流系: 通関関連業者100% 人材系: 派遣会社および請負会社 (構内請負) 100% ● アセスメント結果に応じた改善活動の実施	每期	● 資材系: 調達額の85%以上を達成 物流系: 通関関連業者100%を達成 人材系: 派遣会社および請負会社 (構内請負) 100%を達成 ● 調査を実施したすべてのお取引先さまに対してフィードバックレターを配信。 優先度の高いお取引先さまに対しては個別に是正活動を実施	○	
		● サプライチェーンBCPアセスメントの実施率 資材系: 調達額の85%以上 ● アセスメント結果に応じた改善活動の実施	每期	● 調達額の85%以上を達成 ● 調査を実施したすべてのお取引先さまに対してフィードバックレターを配信	○	

※1  マテリアリティ P.25-26 ※2 TCIR: Total Case Incident Rate. 労働時間20万時間当たりの人身事故発生率 ※3 お客さまの再生可能エネルギー導入による削減を含む

中期経営計画

○: 順調に進行中 △: 目標達成に向けて加速が必要

対象分野		指標	達成時期	2026年3月期実績	進捗評価	関連する主なマテリアリティ※1
社員	エンゲージメント	● エンゲージメント・サーベイのスコア: 継続的な改善 (前回比スコア上昇)、もしくは各地域における他社平均値を超えるスコアを達成	毎回	● 全社共通のパルスサーベイの導入 ● エンゲージメント・サーベイ結果の有効活用と「対話文化※2」の促進 ● 全社共通施策として管理職向け「コーチング」トレーニングを開始	○	
		● 社員の定着率※3 日本: 99% 海外: 業界平均以上	毎期	● 日本: 99.1% ● 海外: 96.2% (業界平均以上)	○	
	キャリア	● 一人ひとりが上長や周囲のサポートを実感し、自分の将来 (キャリアパス) をイメージしながらやりたいことにチャレンジし成長することで、会社の成長や社会のために価値創出できる環境を構築 ● オンライン学習年間利用率率 グローバル: 60%	2027年3月期	● キャリアと学習に関する当社独自のウェブアプリ「Seeker」を開発し、一部の本部やグループ会社に導入を開始。キャリア機会を可視化し、その実現に必要なスキル習得をサポートする学習コンテンツやメンターをAIが提案する仕組みを構築し、社員のチャレンジや行動変容を促進。このような取り組みが評価され、「第14回日本HRチャレンジ大賞」において「大賞」を受賞 ● オンライン学習年間利用率率 グローバル: 45.3%	△	
	ワーク・ライフ・バランス	● 有給休暇取得率 日本: ①80% ②90% 海外: 前期実績と同等以上	日本: ①2027年3月期 ②2031年3月期 海外: 毎期	● 日本: 78.0% ● 海外: 83.2% (前期実績 78.9%)	○	
		● 男性育児休業取得率 日本: 85%	2030年3月期	● 日本: 83.5%	○	
	DE&I	● 女性管理職比率 日本: 5% グローバル: 8%※4	2027年3月期	● 日本: 3.8% ● グローバル: 6.8%	△	
コーポレートガバナンス		● 常に最適で実効性の高い取締役会と攻めの経営執行体制を構築し、取締役会の実効性評価や機関投資家などからの意見を踏まえた課題に継続的に取り組むことで、中長期的な企業価値向上と持続的成長に向けた強固なガバナンスを実現	毎期	● 実効性の高い取締役会を目指して ● 監査役会設置会社を継続、社外取締役比率過半数 (8名中5名) を実現、指名委員会で社外取締役候補者とコンタクト継続 ● オフサイトミーティング2回 (8月、3月) ● 取締役会で原則毎回、CEOによる業務執行に関する重要事項を説明 ● CEOミッション: 取締役会メンバーと共有 ● 代表取締役評価に関するクローズド・セッション: 2回 ● 業務執行を支えるオペレーティングリズム ● コーポレートオフィサーズ・ミーティング: 23回 ● CSSミーティング: 3回 ● 四半期レビュー会議: 4回	○	
リスクマネジメント		● 強固な経営基盤を支える実効性の高いリスクマネジメント体制の構築とさらなる改善 ● 「Safety, Quality and Compliance. Our top priority. It's our pride.」の標語を掲げ、リスクマネジメントおよびコンプライアンス遵守を強化	毎期	● 16項目の主要なリスクについて、リスクオーナーや各工場・現地法人の社長と年次でリスク評価を実施 ● 各領域における重要なリスクに対してリスクオーナーと所管部署を中心に対応強化	○	

※1 マテリアリティ P.25-26

※2 対話文化: サーベイを実施して終わりではなく、結果を共有し、受け止め、改善行動に落とし込むプロセスを組織的に循環させる文化 ※3 定年などによる退職は除く ※4 本目標は当社グループの米国地域には適用されません

中長期的な展望

テクノロジーの進化と半導体の未来

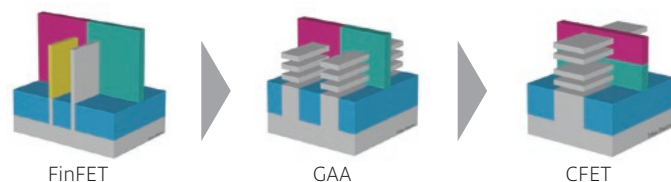
半導体は社会と産業を支える重要な技術です。これまでのIoTやクラウド/エッジコンピューティングによるデジタル化を牽引した「1st Wave」から、現在は、生成AIやAR/VR、自動運転など高度な演算を必要とするアプリケーションがテクノロジードライバーとなる「2nd Wave」に移行しています。これにより、膨大なデータを処理するための半導体需要は一段と高まっており、半導体市場が2030年に1兆米ドル規模に達するという予測は大幅に前倒しされとの見方が広がっています。

一方、半導体市場の成長に伴い電力消費や環境負荷の増大が深刻化しており、大量のデータを処理する半導体の低消費電力化が最優先課題となっています。これらの課題に対応するため、前工程においては微細化を推進することで性能向上を図ります。例えばEUV※1露光の活用や、FinFETからGAA※2やCFET※3などの次世代トランジスタ構造への移行により、素子レベルでの電力効率と高性能の両立を実現します。このためには新材料やプロセスの高度化、設計ルールの最適化、AIを活用したデバイス設計・プロセス制御といった多面的な技術革新が不可欠です。

※1 EUV: Extreme Ultraviolet. 半導体業界では特定の波長13.5nmを使用した露光技術の総称

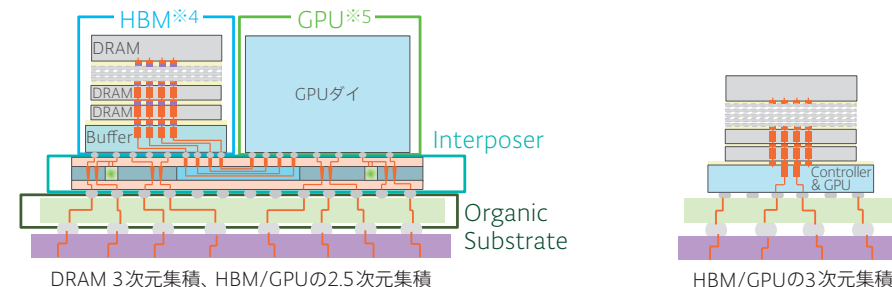
※2 GAA: Gate-All-Around ※3 CFET: Complementary Field Effect Transistor

トランジスタ構造の変化



後工程においてはChipletやヘテロジニアスインテグレーションを含む先端パッケージング技術によって製品の性能・電力・実装密度の最適化を図ります。異なる機能をもつチップの効果的な組み合わせや高密度実装により、システム全体の電力効率と性能を高めることが可能です。また、パネルレベルパッケージは大判基板を用いた高スループットな実装手法で、薄型化やコスト効率の改善に適しています。これらの技術は自動車や通信、AIサーバーなど幅広い領域で歩留まり改善や電力効率向上に貢献します。

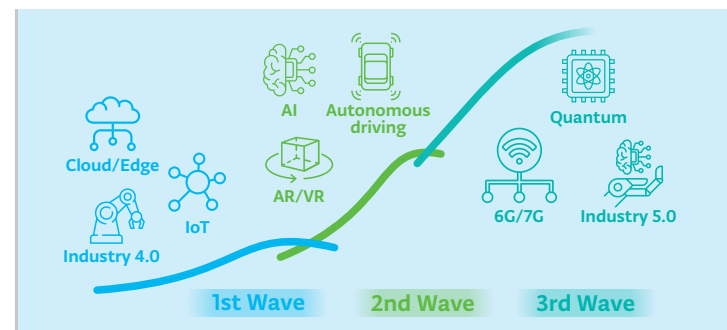
先端パッケージング技術



※4 HBM: High Bandwidth Memory ※5 GPU: Graphics Processing Unit

さらに設計・生産段階でのAI活用により歩留まりとサプライチェーン全体の最適化を推進し、前工程と後工程の取り組みが相互に補完し合うことで、量子コンピューティングや自己学習型AIロボットなどの技術による「3rd Wave」に向けた成長基盤を築きます。

半導体市場の展望



また半導体市場では、高密度化だけでなく、用途に応じた多様かつ最適化されたデバイスが求められています。大規模なデータ処理を担うデータセンターやHPC※6向けの高性能デバイスと、スマートフォンなどのエッジ機器向けの低消費電力デバイスの需要がそれぞれ存在するため、設計・製造・パッケージの各工程における最適化が必要です。加えて、気候変動リスクや原材料・エネルギーの供給リスクに対応するため、デジタル技術を活用したエネルギーの最適化が重要となります。

※6 HPC: High Performance Computing

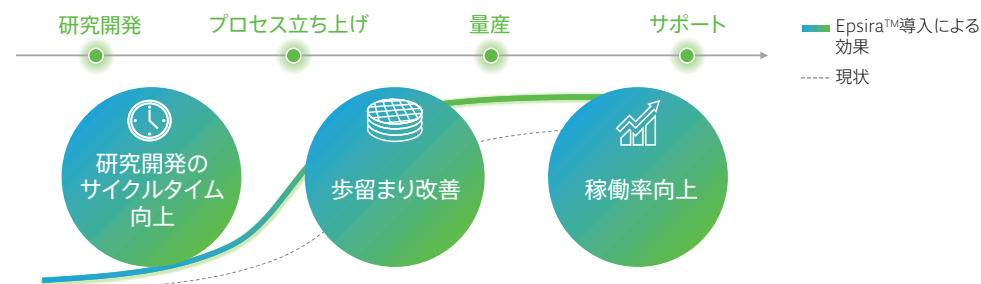
中長期的な展望

半導体製造装置の発展

半導体の進化は、デバイスの高度化と、それを支える製造装置・製造技術の発展が相互に作用することで実現してきました。今後もデバイスの微細化や3次元化が進む中で、製造装置においては、より高い精密制御、高精度なアライメント、ボンディング技術など、ハード面の進化が続いていきます。

一方で、開発期間やコストの削減、さらに世界各地の拠点における装置の早期立ち上げと安定稼働を実現するためには、データやAI、ロボティクスなどを活用したソフト面の革新が不可欠です。研究開発の段階では、データ解析やシミュレーション、AIによる条件予測・最適化を活用することで、実機検証に先立って設計やプロセス条件を絞り込み、試作や実験の回数を減らしながら開発効率を高めています。これにより、開発スピードの向上とコストの削減を同時に実現します。また、装置の稼働データや保守データを活用した分析、予兆検知などにより、装置稼働率の向上や歩留まり改善を図ることも重要です。当社は「Epsira™」の展開を通じて、AIを活用した装置パフォーマンスの最適化や、ロボティクスによる保守作業の自動化などを組み合わせ、製造現場全体のデジタルトランスフォーメーションに取り組んでいます。これまでに培った半導体製造装置の高い専門性とデジタル技術を融合し、お客さまの生産性向上に貢献します。

Epsira™ ビジョン



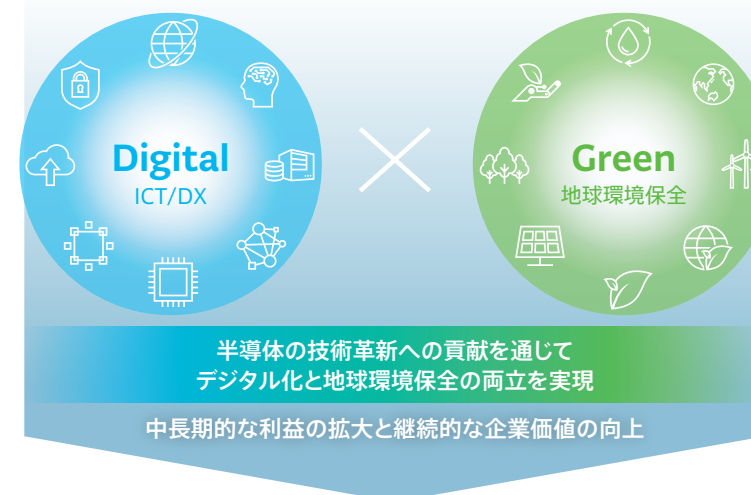
新しい半導体デバイスの構造は装置やプロセス、設計の境界を越えて互いに影響をおよぼします。そのため、トランジスタの構造から配線技術、パッケージの設計までを一貫して検討する「Co-design」の必要性が高まっており、半導体製造装置メーカーにとっては前工程と後工程を含む最適なソリューションの提供がさらに重要になると考えられます。

夢と活力のある会社を目指して

半導体市場は、1st Waveで築かれたデジタル基盤、2nd Waveで加速するAI主導の変革、そして3rd Waveにおける新たなイノベーションにより、今後も大きな成長が見込まれています。

当社は、デジタル化と地球環境保全を両立する「デジタル×グリーン」の実現により、夢のある社会の発展に貢献します。半導体製造装置メーカーとしての高い専門性と価値創出の源泉である社員をはじめとするあらゆる経営資源を戦略的に活用し、革新的な技術をもつ Best Productsと付加価値の高い Best Technical Serviceを継続的に提供します。積極的な開発投資や協業を推進するとともにグローバルなサポート体制を強化し、また産学連携や国際的な仕組みづくりへの貢献などによる業界全体の発展にも寄与していきます。

これからも挑戦と進化を続けることで、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努め、ビジョンの実現による基本理念の実践を通じて、当社を取り巻くすべてのステークホルダーのご期待に応えていきます。



ビジョンを実現し基本理念を実践することで、
会社を取り巻くすべてのステークホルダーのご期待に応える

マテリアリティ

当社はビジョンの実現による基本理念の実践を通じ、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指す上で、優先して取り組むべき重要事項をマテリアリティとして位置づけ、毎年妥当性の確認をおこなっています。また、マテリアリティを軸とした事業活動によるバリューチェーンの展開を通じて、新たな価値の継続的な創出に努めています。

優先して取り組むべき
重要事項
(マテリアリティ)

ビジョンの実現による
基本理念の実践

中長期的な利益の拡大と
継続的な企業価値の向上

マテリアリティの特定プロセス

環境分析・課題の抽出

以下の点を考慮して環境分析をおこない、マテリアリティ候補となる課題を抽出

- 社会における課題
気候変動、人権問題、国家間紛争や地政学上の対立、サプライチェーンマネジメント、技術と倫理、サイバーセキュリティ、物価高騰など
- 事業を取り巻く環境
AIの発展に伴う半導体および半導体製造装置市場のさらなる拡大、地球環境保全への対応、人権尊重の取り組み、コーポレートガバナンスのさらなる強化など
- SDGsの取り組み状況
- ステークホルダーとのエンゲージメント
→ P. 27
- 事業活動における重要リスク
→ P. 65-66

重要性の評価

抽出した課題について、ステークホルダーへの影響や関心を踏まえた「企業が社会や環境に与える影響度」と、継続的な企業価値の向上を見据えた「当社の業績や企業価値への影響度」の二軸で重要性の評価を実施



マテリアリティの特定

- コーポレートオフィス・ミーティングにおける討議と決議
- 取締役会での報告と承認
- 重要事項と評価した課題をマテリアリティとして特定

マテリアリティの検討プロセスについては、第三者である専門家の助言を受けています。

マテリアリティ

特定したマテリアリティ

当社および社会におけるインパクトを確認するとともに、継続的な企業価値の向上に関する重要指標※1やバリューチェーンとの関連性、取り組むSDGs※2を整理し、さまざまな取り組みを推進しています。

マテリアリティ	当社におけるインパクト	社会におけるインパクト	主な取り組み	マテリアリティ	当社におけるインパクト	社会におけるインパクト	主な取り組み
 Climate Change and Net Zero 気候変動とネットゼロ	ネットゼロの達成に向けた事業活動や製品・サービスにおける環境負荷の低減	気候変動リスクの低減と技術・人材・産業などにおける新たな機会の創出	環境 → P. 52-56	 Employee Engagement 従業員のエンゲージメント	価値創出の源泉である社員のパフォーマンスの最大化	リスクの低減やイノベーションの創出などによる経済成長の促進	人材 → P. 48-51
 Product Energy Efficiency 製品の環境性能	製品の環境性能強化およびプロセス性能との両立による製品競争力の向上	環境に配慮した製品の提供による地球環境の保全	研究開発 → P. 29-32 環境 → P. 52-56	 Safety First Operation 安全第一のオペレーション	安全を最優先とすることによる持続的なオペレーションの実現	社会基盤としての安全の構築	据付・保守サービス → P. 41-44 安全 → P. 61
 Best Products with Innovative Technology 革新的な技術をもつ Best Products	革新的な技術をもつ付加価値の高い製品の創出による優位性の確立	半導体の進化による技術革新の促進と社会の発展	研究開発 → P. 29-32 調達・製造 → P. 33-36	 Quality Management 品質マネジメント	高度な品質マネジメントの実践による経営効率の向上	生産性の向上や環境負荷の低減などによる持続可能な社会の構築	調達・製造 → P. 33-36 品質 → P. 62
 Best Technical Service with High Added Value 付加価値の高い Best Technical Service	お客さまの課題を解決する高度なフィールドソリューションの提供による事業機会の拡大	半導体製造における歩留まりや生産性の向上と装置稼働率の最大化	据付・保守サービス → P. 41-44	 Compliance コンプライアンス	法令・規制の遵守による安定的な事業運営と信頼性の向上	社会的責任の実践による社会の健全性向上	コンプライアンス → P. 67-68
 Customer Satisfaction and Trust 顧客満足と信頼	お客さまの唯一無二の戦略的パートナーとして相互利益を拡大	お客さまの価値創造や継続的な成長、産業のさらなる活性化	販売 → P. 37-40	 Ethical Behavior 高い倫理観に基づく行動	社会から高く評価され、従業員が誇りをもてる企業として発展	公正で秩序のある社会の形成	人権 → P. 57-58 コンプライアンス → P. 67-68
 Supplier Relationship サプライヤーリレーションシップ	お取引先さまとの協業による付加価値の創出とサプライチェーンの安定化	サプライチェーン全体における健全性の維持や優位性の強化	調達・製造 → P. 33-36 環境 → P. 52-56 サプライチェーンマネジメント → P. 59-60	 Information Security 情報セキュリティ	安全・安心にデータを活用できる環境を整備し継続的かつ確実に事業を展開	情報の利便性と安全性の確保による社会インフラの安定化	情報セキュリティ → P. 64
 Respect for Human Rights 人権の尊重	事業活動における人権リスクの低減・排除と、いきいきと活動できる企業文化の醸成	差別や不平等、労働や安全などの人権に関わる社会課題の解決	人権 → P. 57-58	 Enterprise Risk Management エンタープライズリスクマネジメント	事業上のリスクの適切な管理と対応によるレジリエンスの強化	リスクの排除や低減による経済や社会の継続的な発展	リスクマネジメント → P. 65-66

※1  継続的な企業価値の向上に関する重要指標 P. 21-22

※2  当社ウェブサイト「マテリアリティ」 www.tel.co.jp/sustainability/materiality/index.html

ステークホルダーエンゲージメント

当社では、ステークホルダーとの対話の機会を積極的に設け相互コミュニケーションを図ることにより、ステークホルダーからの要請や期待を的確に把握し事業活動を展開しています。社会における役割と責任を確実に果たしていくことで、当社を取り巻くすべてのステークホルダーとの確固たる信頼関係の構築に努めています。

ステークホルダー	ステークホルダーとの関係性	ステークホルダーへの提供価値	主なエンゲージメント機会
株主・投資家さま	- 株主・投資家さまは、当社に資本を提供するとともに、建設的な対話や株主総会での議決権の行使を通して、株主・投資家さま視点でのご意見やご要望、当社への期待を明示 - 当社は、経営ビジョンや成長シナリオを共有するとともに、株主・投資家さまからいただいたご意見やご要望を経営に生かし、企業価値の向上を図る	- 事業活動により創出した利益の還元 - 中長期的な成長の実現による企業価値の向上	- 決算説明会/中期経営計画説明会/IR Day - IRカンファレンス/IRロードショー※1/個別IR取材 - 株主総会 - 国内外の主要な半導体やテクノロジー関連の展示会で併催される投資家向けイベント（CEO登壇） ※1 IRロードショー：株主・投資家さまを直接訪問するIR活動
お客さま	- お客さまは、当社が提供する半導体製造装置を購入するとともに、装置のメンテナンスなどに必要なサービスを利用 - 当社は、製品やサービスおよびソリューションの提供のみならず、お客さまと複数世代にわたる技術ロードマップを共創し、共同で技術開発を実施	- 革新的な技術をもつBest Products - 付加価値の高いBest Technical Service - 安全と品質を重視し、環境に配慮した製品やサービス - 多様なアプリケーションに対応するソリューション	- 技術交流会 - 共同開発 - 顧客満足度調査
お取引先さま	- お取引先さまは、当社の事業運営において必要な資材や人材、また通関やロジスティクスなどの役務を提供 - 当社は、お取引先さまが提供する資材や役務などを購入するとともに、それらの開発や改善および品質向上に協働して取り組む。また労働、環境、安全衛生、倫理などに配慮したサステナブルなサプライチェーンを構築	- 当社との協働による製品やサービスの付加価値の向上と社会課題への取り組みの推進 - 半導体製造装置市場における事業機会 - サプライチェーン全体における健全性の維持や競争力の強化	- 生産動向説明会 - TEL/パートナーズデイ/TEL E-COMPASS Day - サステナビリティアセスメント - STQA※2監査 ※2 STQA: Supplier Total Quality Assessment
社員	- 社員は、個々の能力を生かし、また教育機会の活用などにより成長を図ることで、企業価値の向上に寄与 - 当社は、社員のやる気を重視した経営のもと、エンゲージメントの向上を推進	- 夢と活力に満ち、組織と個人における相互信頼のもと存分に能力を発揮できる職場環境 - キャリア形成やスキルアップの機会 - 公正な人事評価と成果に見合った報酬	- 社員集会 - グローバル・エンゲージメント・サーベイ - 研修やワークショップ
地域社会	- 地域社会は、地場産業の発展や人材の育成などを図り、地域社会としての価値向上に努める - 当社は、事業を展開する地域において雇用機会の創出や環境保全の取り組み、納税などにより、地域社会の発展に貢献	- 人材育成と雇用機会 - 地域における環境保全の推進 - 納税による財務的な貢献	- TEL FOR GOOD (社会貢献活動) - 事業所見学会 - 環境報告会
行政機関・各種団体	- 行政機関・各種団体は、法令や条例、業界行動規範などの遵守を企業に求めるとともに、企業と連携し産業全体および国や地域レベルでの発展を目指す - 当社は、事業を展開する国や地域において、法令や条例、業界行動規範などを遵守した事業活動をおこなうとともに、社会の要請を的確に捉え、課題解決や発展に貢献	- 産業や社会の課題解決や発展に貢献するソリューション - 法令や条例、業界行動規範などを遵守した事業活動	- 政府・行政機関との連携 - 国際的なイニシアティブやNGOなどとの協働 - 業界団体における活動